



中华人民共和国国家标准

GB/T 10189—2013/IEC 60384-13-1:2006
代替 GB/T 10189—1988

电子设备用固定电容器 第 13-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ

Fixed capacitors for use in electronic equipment—
Part 13-1: Blank detail specification—
Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c. capacitors—
Assessment level E and EZ

(IEC 60384-13-1:2006, IDT)

2013-12-31 发布

2014-08-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

《电子设备用固定电容器》系列国家标准分为如下若干部分：

- 第 1 部分：总规范(GB/T 2693—2001/IEC 60384-1:1999)；
- 第 2 部分：分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 7332—2011/IEC 60384-2:2005)；
- 第 2-1 部分：空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 7333—2012/IEC 60384-2-1:2005)；
- 第 3 部分：分规范 表面安装 MnO₂ 固体电解质钽固定电容器(IEC 60384-3:2007)；
- 第 3-1 部分：空白详细规范 表面安装 MnO₂ 固体电解质钽固定电容器 评定水平 EZ(IEC 60384-3-1:2007)；
- 第 4 部分：分规范 固体和非固体电解质铝电解电容器(GB/T 5993—2003/IEC 60384-4:1998,第 1 号修改单:2000)；
- 第 4-1 部分：空白详细规范 非固体电解质铝电解电容器 评定水平 EZ(GB/T 5994—2003/IEC 60384-4:2000)；
- 第 4-2 部分：空白详细规范 固体(MnO₂)电解质的铝电解固定电容器 评定水平 EZ(IEC 60384-4-2:2007)；
- 第 6 部分：分规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-6:2005)；
- 第 7 部分：分规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10185—2012)；
- 第 7-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(GB/T 10186—2012)；
- 第 8 部分：分规范 1 类瓷介固定电容器(GB/T 5966—2011/IEC 60384-8:2005)；
- 第 8-1 部分：空白详细规范 1 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5967—2011/IEC 60384-8-1:2005)；
- 第 9 部分：分规范 2 类瓷介固定电容器(GB/T 5968—2011/IEC 60384-9:2005)；
- 第 9-1 部分：空白详细规范 2 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5969—2012/IEC 60384-9-1:2005)；
- 第 11 部分：分规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-11:2008)；
- 第 11-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-11-1:2008)；
- 第 13 部分：分规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-13:2011)；
- 第 13-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 10189—2013/IEC 60384-13-1:2006)；
- 第 14 部分：分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器(GB/T 14472—1998/IEC 60384-14:2005)；
- 第 14-1 部分：空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平 D(GB/T 14473—1998/IEC 60384-14-1:2005)；
- 第 15 部分：分规范 非固体或固体电解质钽固定电容器(GB/T 7213—2003/IEC 60384-15:1982,第 1 号修改单:1987,第 2 号修改单:1992)；

- 第 15-1 部分:空白详细规范 固体电解质钽箔固定电容器 评定水平 E(GB/T 12794—1991/IEC 60384-15-1:1984);
- 第 15-2 部分:空白详细规范 固体电解质烧结钽固定电容器 评定水平 E(GB/T 12795—1991/IEC 60384-15-2:1984);
- 第 15-3 部分:空白详细规范 固体电解质和多孔阳极钽固定电容器 评定水平 E(GB/T 7214—2003/IEC 60384-15-3:1984);
- 第 16 部分:分规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器(GB/T 10190—2012/IEC 60384-16:2005);
- 第 16-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 10191—2011/IEC 60384-16-1:2005);
- 第 17 部分:分规范 金属化聚丙烯薄膜介质交流和脉冲固定电容器(GB/T 14579—2013/IEC 60384-17:2005);
- 第 17-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质交流和脉冲固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 14580—2013/IEC 60384-17-1:2005);
- 第 18 部分:分规范 表面安装固体和非固体电解质铝电解固定电容器(GB/T 17206—1998/IEC 60384-18:1993,第 1 号修改单:1998);
- 第 18-1 部分:空白详细规范 表面安装固体(MnO₂)电解质铝固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 17207—2012/IEC 60384-18-1:2007);
- 第 18-2 部分:空白详细规范 非固体电解质片式铝电解质固定电容器 评定水平 E(GB/T 17208—1998/IEC 60384-18-2:1993);
- 第 19 部分:分规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 15448—2013/IEC 60384-19:2006);
- 第 19-1 部分:空白详细规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 16467—2013/IEC 60384-19-1:2005);
- 第 21 部分:分规范 表面安装 1 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21041—2007/IEC 60384-21:2004);
- 第 21-1 部分:空白详细规范 表面安装 1 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21038—2007/IEC 60384-21-1:2004);
- 第 22 部分:分规范 表面安装 2 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21042—2007/IEC 60384-22:2004);
- 第 22-1 部分:空白详细规范 表面安装 2 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21040—2007/IEC 60384-22-1:2004)。

本部分为《电子设备用固定电容器》的第 13-1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 10189—1988《电子设备用固定电容器 第 13-1 部分:空白详细规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ》。本部分与 GB/T 10189—1988。相比,主要变化如下:

- 增加了评定水平 EZ 的要求;
- 质量一致性检验试验一览表中增加了 A0 分组检验、B 组检验由 D 改为 ND,并增加标志耐溶剂试验、C1A 分组增加元件耐溶剂试验;
- 低气压试验气压由 8.5 kPa 改为 8 kPa;
- A1 分组 IL 由 S-4 改为 S-3;
- A2 分组 IL 由 II 改为 S-3;

——规范名称由“第 13 部分”改为“第 13-1 部分”。

本部分使用翻译法等同采用 IEC 60384-13-1:2006《电子设备用固定电容器 第 13-1 部分:空白详细规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ》。

与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:

——GB/T 2693—2001 电子设备用固定电容器 第 1 部分:总规范 (idt IEC 60384-1:1999);

——GB/T 10188—2013 电子设备用固定电容器 第 13 部分:分规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-13:2006, IDT)。

本部分进行了下列编辑性修改:

——IEC 第 2 页注 2 改为注 1;

——对 IEC 60384-13-1:2005 中编辑性错误进行勘误,在表 4 中的 4.7.2 最后测量,补充“损耗角正切”测量要求。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国电子设备阻容元件标准化技术委员会(SAC/TC 165)归口。

本部分起草单位:成都宏明电子股份有限公司。

本部分主要起草人:安卫军、董小婕。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 10189—1988。

电子设备用固定电容器

第 13-1 部分:空白详细规范

金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器

评定水平 E 和 EZ

引言

空白详细规范

空白详细规范是分规范的一种补充性文件,它包括对详细规范的格式、编排和最少内容的要求。不遵守这些要求的详细规范,认为是不符合电子元件质量评定体系要求的规范。在制定详细规范时,应考虑分规范 1.4 的内容。

详细规范和电容器的识别

详细规范首页括号中的数字表明在对应的位置应填写下列相应内容:

- (1) 授权起草本详细规范的组织:IEC 或国家标准机构。
- (2) IEC 或国家标准的详细规范编号、发布日期以及国家标准体系需要的其他内容。
- (3) IEC 或国家标准的总规范编号及其版本号。
- (4) IEC 或国家标准的空白详细规范编号。

电容器的识别

- (5) 该型号电容器的简述。
- (6) 典型结构的说明(适用时)。

注:当电容器不是设计用于印制电路板时,应在详细规范的这个位置明确地加以说明。

(7) 影响互换性的主要尺寸的外形图和(或)引用国家或国际的外形方面的文件。此外,也可以在详细规范附录中给出这种图。

- (8) 涉及的应用或应用组别和(或)评定水平。

注:详细规范中采用的一个或几个评定水平,应从分规范 3.5.4 中选取。这意味着只要试验的分组不变,几个评定水平可以共用一个空白详细规范。

- (9) 重要的特性参考数据,以便在各种不同类型电容器之间进行比较。